

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中信证券、理成资产、睿华资本、平安证券、大家资产、淡水泉、宝盈基金、德邦证券、中信建投、华鑫电子、诺安基金、嘉合基金、太平基金、富国基金、天弘基金
时间	2024年6月26日-2024年6月28日
地点	公司会议室及线上
上市公司接待人员姓名	常务副总经理、董事会秘书：陈小华 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司的研发或产品应用策略？ 回答：随着公司产品应用的发展和延伸，公司逐步形成“一主两翼”的业务发展格局，“一主”是半导体电镀光刻，包括先进封装和晶圆制造领域，“两翼”是半导体显示、光伏新能源领域。公司聚焦主营业务，围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节。在电镀液及配套试剂方面，公司在持续夯实传统封装国内龙头地位的基础上，逐步在先进封装以及晶圆28nm、14nm先进制程取得突破，在光刻胶及配套试剂方面，公司也是聚焦于特色工艺光刻胶。 问题二：先进封装负性光刻胶的技术难点？

	<p>回答：公司自产的先进封装用负性光刻胶用于制造 Bumping 铜凸块，铜凸块宽度一般为 20 μm，因此该款光刻胶的分辨率达到 20 μm 即可满足要求。但由于其开口深度远高于一般图形结构，要求光刻胶的涂布厚度达到 50-110 μm，是一般光刻胶涂布厚度的 50-100 倍，因此该款光刻胶对于涂布厚度、与基材结合力的要求高于一般光刻胶。此外，光刻胶显影后形成的开口经过电镀铜、电镀镍和电镀锡银（其中电镀铜用量最大）工艺完成铜凸块制造，因此该款光刻胶还需要耐受电镀。该款光刻胶的配方复杂度高，重要原材料树脂被国外光刻胶企业独家垄断供应来源，无外购渠道，由公司自行合成。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 28 日